19p-D9-6

超解像ラマン分光法による微細加工歪 SiGe 層に生じる応力緩和の高空間分解能 2 次元分布評価 Two-dimensional Evaluation of Stress Relaxation Profile

in Strained SiGe Nanostructures on Si Substrate by SRRS

明治大学理工学部¹、学振特別研究員 DC²、産総研 連携研究体が リーン・ ナノエレクトロニクスセンター(GNC)³ の富田 基裕^{1,2}、小瀬村 大亮¹、臼田 宏治³、小椋 厚志¹

Meiji Univ.¹, JSPS Research Fellow DC², Collaborative Research Team Green Nanoelectronics Center (GNC), AIST³, ^oMotohiro Tomita^{1, 2}, Daisuke Kosemura¹, Koji Usuda³, and Atsushi Ogura¹ E-mail: mot tom@meiji.ac.jp

【はじめに】 歪 SiGe はポストスケーリング技術における次世代チャネル材料候補であり、次世代トランジスタへの応用が期待されている。しかしながら、グローバル歪 SiGe 層をチャネルとする微細トランジスタでは、微細化が進むにつれて歪層の応力緩和が不可避となり、応力緩和の高空間分解能評価が重要となる。そこで今回、超解像ラマン分光(SRRS)法を SiGe 微細構造の 2 次元ひずみ緩和評価に初めて適用し、併せて電子線後方散乱パターン(EBSP)法、有限要素法(FEM)も比較検討したので報告する。

【実験】Fig. 1に試料構造および測定領域を示 す。膜厚30 nm、Ge濃度30%のSiGe層を持つSi 基板に対し、電子線リソグラフィおよび反応性 イオンエッチングによりX = 1000 nm、Y = 5000 nmの微細SiGeメサ構造を形成後、種々の測定 をメサの1/4領域で行った。ラマン分光測定に は励起光源として波長532 nmのNd:YAGレー ザーを、対物レンズには油浸レンズ(NA = 1.4) を用い、その結果に超解像のアルゴリズムには Bilateral total variation法を適用した[1]。EBSPは FE-SEMに装備され、プローブ径は最小で20 × 60 nmである。全ての測定は加速電圧20 kVで行 われ、検出深さは約30-50 nmである。FEMでは 約11,000の六面体要素を用いた3次元歪モデル を用いた。

【結果】Fig. 2 にラマン分光法にて評価した、 $\sigma_{xx} + \sigma_{yy}$ 応力の超解像処理前後の 2 次元分布を 示す。メサパターン中央部の応力は約-3.0 GPa であり、試料が緩和していない事を確認した。 一方、エッジ部分の応力緩和は、超解像前で -2.5 ~ -2.0 GPa であり、超解像後は-2.0 ~ -1.5 GPa である。超解像後の応力値:-1.5 GPa はパターン中央部の応力の半分となり、エッジ に垂直な σ_{xx} もしくは σ_{yy} 応力が完全に緩和し ていると判断できる。Fig. 3 に EBSP によって 評価した $\sigma_{xx} + \sigma_{yy}$ 応力および FEM によって評 価した緩和応力成分(中間主応力)の 2 次元分布 を示す。SRRS の結果は Fig. 3 に示した結果と 良い相関が取れている。即ち、超解像ラマン分 光(SRRS)法を用いることで、EBSP の実用空間 分解能と同等である sub-100 nm の空間分解能 による 2 次元評価を達成し、SiGe 歪層のエッ ジ緩和評価に有効である事を示す事ができた。 本研究の一部は、科研費基盤研究 B (24360125) および最先端研究開発支援プログラムにより 補助を受けたものである。



in SiGe layer obtained by EBSP and FEM.